DOCKET NO. 0160-0193-0 PCT

**09 / 4** 63 9 6 **1**410 Rec'd PCT/PTO 1 0 FEB 2000

### IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Hiroshi IKEDA, et al

SERIAL NUMBER: NEW U.S. PCT APPLICATION (based on PCT/JP98/04666)

FILED: HEREWITH

FOR: PROCESS AND APPARATUS FOR TREATING SEMICONDUCTOR PRODUCTION

**EXHAUST GASES** 

# REQUEST FOR CONSIDERATION OF DOCUMENTS CITED IN INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Assistant Commissioner for Patents Washington, D.C. 20231

Sir:

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that applicant(s) request that the Examiner consider the documents cited in the International Search Report according to MPEP §609 and so indicate by a statement in the first Office Action that the information has been considered. When the Form PCT/DO/EO/903 indicates both the search report and copies of the documents are present in the national stage file, there is no requirement for the applicant(s) to submit them (1156 O.G. 91 November 23, 1993).

Respectfully submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND, MAIER & NEUSTADT, P.C.

Norman F. Oblon
Atterney of Record
Registration No. 24,618

William E. Beaumont Registration No. 30,996

Fourth Floor 1755 Jefferson Davis Highway Arlington, Virginia 22202 (703) 413-3000 Fax No. (703) 413-2220 (OSMMN 1/97) the state of the feet and

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Ì

# 世界知的所有権機関国 際 事 務 局

# 特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類6

B01D 53/75, 53/78

(11) 国際公開番号 A1 WO99/20374

(43) 国際公開日

1999年4月29日(29.04.99)

(21) 国際出願番号

PCT/JP98/04666

(22) 国際出願日

1998年10月15日(15.10.98)

(30) 優先権データ

特願平9/299671

1997年10月17日(17.10.97) JP

(71) 出願人(米国を除くすべての指定国について) 株式会社 荏原製作所(EBARA CORPORATION)[JP/JP] 〒144-8510 東京都大田区羽田旭町11番1号 Tokyo, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

池田 宏(IKEDA, Hiroshi)[JP/JP]

〒224-0041 神奈川県横浜市都筑区仲町台1-13-17-616

Kanagawa, (JP)

久保田泰弘(KUBOTA, Yasuhiro)[JP/JP]

〒224-0041 神奈川県横浜市都筑区仲町台1-13-17-523

Kanagawa, (JP)

京谷敬史(KYOTANI, Takashi)[JP/JP]

〒241-0822 神奈川県横浜市旭区さちが丘85-1-101

Kanagawa, (JP)

(74) 代理人

弁理士 社本一夫, 外(SHAMOTO, Ichio et al.) 〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大手町ビル206区 ユアサハラ法律特許事務所

Tokyo, (JP)

(81) 指定国 JP, KR, US, 欧州特許 (DE, FR, GB).

添付公開書類

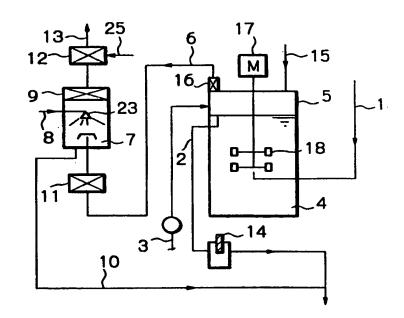
国際調査報告書

(54)Title: METHOD AND APPARATUS FOR PROCESSING EXHAUST GAS OF SEMICONDUCTOR FABRICATION

(54)発明の名称 半導体製造排ガスの処理方法及び装置

#### (57) Abstract

A method of, and apparatus for, processing exhaust gas by using an aeration/agitation tank (5) containing an alkaline aqueous solution, a gas-liquid contact device (7) and/or a packing column (11). Harmful substances that cannot be completely removed in the aeration/agitation tank such as water-soluble organic compounds, e.g. ethanol, halogenated silicon compounds, e.g. SiCl<sub>4</sub>, and halogen gasses, e.g. F<sub>2</sub>, Cl<sub>2</sub> are removed at the succeeding stage. The method and the apparatus are suitable particularly for purifying the exhaust gas exhausted from a semiconductor fabrication apparatus.



ī

ł

アルカリ性水性液を用いる通気攪拌槽(5)と、気液接触装置(7)及び/又は充填塔(11)と、を有する排ガスを処理する方法及び装置。通気攪拌槽で除去しきれない有害ガス、例えば、エタノール等の水溶性有機化合物、 $SiCl_4$ 等のハロゲン化シリコン化合物、 $F_2$ 、 $Cl_2$ 等のハロゲンガス等を後段で除去することができる。半導体製造装置から排出される排ガスの浄化に特に適している。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

EFFFGGGGGGGGGHHIIIIIIJKKKKKL スフフガ英ググガガギギギクハイアイイアイ日ケキ北韓カセペィラボ国レルーンニニリロンンイスンイタ本ニル朝国ザンンテスン ゲア ア・ャチリネラエ ラア ス スルンシス ダア ア・ャチリネラエ ラア ス スルンシス ダア ア・ャチリネラエ ラア ス スルンシス グア ア・マチリネラエ ラア ス スルンラス ダア ア・マチリネラエ ラア ス スルンラス ダア ア・マチリネラエ ラア ス スルンシス 

#### 明細書

#### 半導体製造排ガスの処理方法及び装置

### 5 発明の属する技術分野

本発明は、排ガスの処理に係り、特に、半導体製造装置から排出される排ガスから有害成分を除去する方法及び装置に関する。

#### 従来の技術

現在の半導体製造産業では、シリコンウェハのドライエッチング及びチャンバ -クリーニング等の工程で $CF_4$ 、 $CHF_3$ 、 $C_2F_6$ 、 $C1_2$ 、HBr、HCl、 $BCl_3$ 、 $C1F_3$ 等、またシリコンウェハのCVD工程でテトラエトキシシラン(以下、TEOSという)、 $NH_3$ 、 $SiH_2Cl_2$ 等が使用されている。これらの工程の排ガスには、上記の末反応ガスの他、 $SiF_4$ 、 $F_2$ 、HF、 $SiCl_4$ 、 $CH_3CHO$ 、 $CH_3OH$ 、 $C_2H_5OH$ 等の分解生成物も含まれており、そのまま排出できないものなので、除害装置により有害成分を除去した後に排出されている。

除害装置には大きく分けて、固形吸着剤を用いる乾式のものと、薬液を用いる 湿式のものとがある。

従来の半導体製造排ガスの除害装置には次のような問題点がある。

#### 20 (乾式の場合)

- 一般的に処理性能が高く、除害出口の有害成分濃度を作業環境許容濃度以下にすることができるが以下の問題点がある。
- (1) 固形吸着剤が消耗するたびに交換する必要があり、ランニングコストが高い。
- 25 (2) 固形反応生成物を含む排ガスの場合、閉塞が生じる場合がある。
  - (3)使用済吸着剤は有害成分を高濃度に濃縮しているので、処理に手間とコストがかかる。また、高濃度に濃縮しているので、発熱等のトラブルが起こる場合

がある。

5

#### (湿式の場合)

一般的にランニングコストは安価であるが、以下の問題点がある。

- (1) 一般の湿式の場合、処理性能が低く、除害出口で有害成分を作業環境許容 濃度以下にすることが難しい。また、処理対象成分が少ない。
  - (2) 一般の湿式の場合、処理装置の後段で固体の反応生成物 ( $NH_4C1$ 、S i O, 、B,O<sub>3</sub>等) が生成され、閉塞を起こす場合がある。
  - (3) 一般の気泡塔の場合、排ガス流入側が正圧になり、上流側真空ポンプ等に 高負荷を与える場合がある。
- 10 (4)ジェットスクラバ式の場合、循環ポンプにて固形生成物に上るトラブルを 起こす場合がある。

そして、これらの除害装置は、クリーンルームの内部に設けられることがある ので、除害装置がクリーンルームの汚染源になってはならないという制約もある。

#### 15 本発明の概要

25

本発明は、上記問題点を解消し、排ガス中の有害成分の除去率を高く保ち、固 形生成物による閉塞を抑制でき、ランニングコストが安価な半導体製造排ガスの 処理方法と装置を提供することを課題とする。

本発明の一側面では、通気攪拌槽中のアルカリ性水性液を攪拌しつつ、排ガス 20 をアルカリ性水性液に導入する工程と、通気攪拌槽から排出されるガスから更に 有害ガスを除去する工程と、を有することを特徴とする排ガスの処理方法が提供 される。

本発明において、前記除去工程が、通気攪拌槽から排出されるガスを水性液に接触させる工程を有することが好ましい。あるいは、前記除去工程が、通気攪拌槽から排出されるガスを薬剤を充填した充填塔に導入させる工程を有することが好ましい。あるいは、前記除去工程が、通気攪拌槽から排出されるガスを水性液に接触させる工程と、通気攪拌槽から排出されるガスを薬剤を充填した充填塔に

導入させる工程と、を有することが好ましい。

前記アルカリ性水性液がアルカリ金属元素を含まない水溶液であり、前記水溶液のpHが7.1~10であることが好ましい。

また、通気攪拌槽から排出されるガスが、ガス移動装置により移動させられる ことが好ましい。ガス移動装置としては、気液接触装置又は充填塔の下流に設け られるガス吸引器が挙げられる。しかし、ガス移動装置として、気液接触装置又 は充填塔の上流にファン等を設けても良い。

半導体デバイス製造装置から排ガスを放出する工程を更に有し、この排ガスを 上記導入工程で上記アルカリ性水性液に導入することが好ましい。

10 本発明の他の側面では、アルカリ性水性液を攪拌しつつ、排ガスをアルカリ性水性液に導入するための通気攪拌槽と、前記通気攪拌装置から排出されたガスを水性液に接触させるための気液接触装置、及び、前記通気攪拌装置から排出されたガスを通すための、薬剤を充填した充填塔の少なくとも一方と、を有する排ガスの処理装置が提供される。

15 本発明において、前記気液接触装置を有することが好ましい。あるいは、本発明において、前記充填塔を有することが好ましい。あるいは、前記気液接触装置及び前記充填塔を有することが好ましい。

また、通気攪拌槽を通過したガスを移動させるための、ガス移動装置を更に有することが好ましい。

20 更に、半導体デバイスの製造装置から排出される排ガスを前記通気攪拌槽に導入するための通路を有することが好ましい。

本発明では、通気攪拌槽で、HC1、HF等の酸性ガス、テトラエトキシシリコン等の有機シリコン化合物、 $BC1_3$ 、 $SiC1_4$ 等の無機ハロゲン化合物が除去される。

25 そして、本発明では、通気攪拌槽で除去しきれない有害ガス、例えば、アンモニア、アミン等のアルカリ性ガス、エタノール、アセトアルデヒド等の水溶性有機化合物、SiCl<sub>4</sub>等のハロゲン化シリコン化合物、F<sub>2</sub>、Cl<sub>2</sub>等のハロゲン

ガス等を後段の気液接触装置又は充填塔で除去することができる。また、微量の酸性ガス、例えば、HCl、HF等がアルカリ性水性液を通過する場合があるので、このような微量の酸性ガスも後段で除去することができる。

気液接触装置は、特に、水溶性有機化合物、酸性ガス、アルカリ性ガスを除去 するのに適している。一方、薬剤を充填した充填塔は、特に、ハロゲン化シリコ ン化合物、ハロゲンガス等を除去するのに適している。

なお、本発明では、 $CF_4$ 、 $CHF_3$ 、 $C_2F_6$ 等の有機フッ素化合物を除去することを目的としていない。これらの有機フッ素化合物は、化学的に安定であり、半導体製造を格別に阻害しないからである。

10 本発明では、半導体製造排ガスを、アルカリ性溶液と接触させて有害成分を除去する排ガスの処理方法において、前記排ガスとアルカリ性溶液の接触を通気撹拌槽で行い、該接触させた後のガスを更に水と接触させると共に、これらのガスと溶液との接触を後段でのガス吸引によって行ってもよい。

また、本発明では、半導体製造排ガスを、アルカリ性溶液と接触させて有害成分を除去する排ガスの処理装置において、前記排ガスとアルカリ性溶液を接触させる通気撹拌槽と、該撹拌槽からの排ガスを水と接触させる気液接触装置とを設置し、それらの装置の後段にガスを吸引するガス吸引器を設けてもよい。

前記本発明においては、排ガスを水と接触させる前又は後に、薬剤を充填した 充填塔で排ガスを薬剤と接触させることができ、また、前記アルカリ性溶液は、

20 アンモニア又はアミン等のアルカリ金属元素を含まない水溶液を用い、そのpH 値は7.1~10、特に8.0~9.5とするのが良い。

#### 図面の簡単な説明

5

15

- 図1は、本発明の処理装置の一例を示す全体構成図である。
- 25 図2は、本発明の処理装置の他の例を示す全体構成図である。
  - 図3は、本発明の処理装置の別の例を示す全体構成図である。
  - 図4(a)及び図4(b)は、本発明で用いる通気撹拌槽の断面図である。

図5 (a)及び図5 (b)は、本発明で用いる気液接触装置の断面図である。 図6は、本発明の処理装置の別の例を示す全体構成図である。

#### 発明の好ましい実施態様

10

15

20

25

5 次に、本発明を図面を用いて詳細に説明する。

図1~図3に、本発明の半導体製造排ガスの処理装置の全体構成図を示す。

図1~3において、1は半導体製造排ガス、2はオーバフロー管、3はアルカリ液、4は洗浄液(アルカリ性溶液)、5は通気撹拌槽、6はアルカリ処理排ガス、7は気液接触装置、8は水、9及び16はデミスタ、10は排水管、1 1は充填塔、12は吸引器、13は処理ガス、14はpH測定器、15は水である。 先ず、図1を用いて本発明を説明する。

図1は、充填塔11を設けていない例であり、半導体製造排ガス1は、まず水 15又はアルカリ溶液3でpH7.1から10望ましくはpH8.0から9.5 に調整したアルカリ性の洗浄液4と通気撹拌槽5において接触される。ここで大 部分の除去成分は洗浄液に吸収除去される。

アルカリ性水性液では、例えば、下記の反応により、化合物が加水分解する。

$$2 B C I_3 + 3 H_2 O \rightarrow B_2 O_3 + 3 H C I$$
  
 $S i (O C_2 H_5)_4 + 2 H_2 O \rightarrow S i O_2 + 4 C_2 H_5 O H$   
 $S i C I_4 + 2 H_2 O \rightarrow S i O_2 + 4 H C I$ 

また、HF、HC1、HBr等の酸性ガスはアルカリ性水性液に吸収される。 アルカリ溶液としては、通常のアルカリ性物質の水溶液が使用できるが、水酸 化ナトリウムや水酸化カリウムに含まれるNaやK等のアルカリ金属元素は半導 体製造において極く微量でも有害成分として作用するので、できれば、アンモニ ア、アンモニアの炭酸塩、アンモニアの燐酸塩、アミン等のアルカリ金属元素を 含まないアルカリ液を使用するのが好ましい。

通気撹拌槽5としては、図4(a)及び図4(b)に記載のような、液中で撹拌羽根を高速回転させてガスを分散させるものが使用できる。通気攪拌槽は、アルカリ性液を保持するための槽と、アルカリ性液を攪拌するための攪拌手段と、排ガスをアルカリ性液中に導入するための排ガス導入部とを有することが好ましい。攪拌手段は、例えば、モータと、モータに回転可能に連結する軸と、軸に固定される羽根とを有する。排ガスは、排ガス導入部の出口からアルカリ性液中に導入される。この排ガス導入部の出口は、攪拌手段の羽根の近傍であることが好ましい。

5

15

図4(a)、図4(b)、図5(a)及び図5(b)において、17はモータ 10 - 、18は撹拌羽根、19はガス導入直管、20は邪魔板、21は多孔管、22 は充填物、23はスプレーノズル、24は水洗浄された排ガス、25は空気であ る。

図4 (a) は、モーター17に直結された、円盤状の円周部に直角タービン羽根を2枚以上付けた撹拌羽根18 (ディスクタービン羽根)を液中で高速回転させ、その撹拌羽根のすぐ直下より直管19にてガスを導き、撹拌羽根のせん断力にて微細気泡にし液中にガス分散させるものであり、また、その撹拌羽根は液中での気泡の滞留時間と撹拌羽根のせん断力を増すため、上下2段に設置し高速回転させることが好ましい。

図4(b)は、モーター17に直結された、円盤状の円周部に直角タービン羽 根を数枚付けた撹拌羽根18(ディスクタービン羽根)を液中で高速回転させ、 その撹拌羽根のすぐ直下よりガスを多孔管21にて微細化した状態で導き、さら にその真上に設置の撹拌羽根のせん断力にてより微細気泡にし液中にガス分散さ せるものである。なお、20は邪魔板である。

このように、本発明で通気撹拌槽を用いている理由を以下に説明する。

25 一般に広く使用されている充填塔等の液分散型湿式吸収装置で、高濃度の酸性 ガスをアルカリ液で処理した場合には、中和反応によって生成した塩を含むミストが発生する。たとえば、HCl含有ガスをアンモニア水を中和液に用いて処理

すると、 $NH_4C1$ を含むミストが発生する。また、水酸化ナトリウムを中和液に用いた場合には、NaC1を含むミストが発生する。また、 $BC1_3$ や $SiF_4$ を湿式処理した場合には、これらの加水分解生成物である $B_2O_3$  や $SiO_7$  を含むミストが発生する。これらの生成物は、処理装置後段に堆積し、閉塞等のトラブルを起こす場合があるので、発生を加える必要がある。

5

10

15

25

これらのミストは、吸収装置内に存在する洗浄液の微粒子や、洗浄液から揮発する成分(たとえば水分子やアンモニア分子)と、処理対象成分が反応することによって生成すると考えられる。一般に、気体分子の拡散係数が $10^{-5}$ m²/s e c のオーダーであるのに対して、このようなミストの拡散計数は $10^{-3}\sim10^{-11}$  m²/s e c のオーダーであると言われており、拡散速度が極めて遅い。

一般に湿式吸収装置では、処理対象成分が液に溶解する結果、気液界面の気相 濃度が低下し、近傍の気相に濃度勾配が生じる。この濃度勾配によって処理対象 成分が拡散輸送され、処理対象成分の液への溶解が促進される。拡散による輸送 量は、処理対象成分の拡散係数に比例する。ところが、上述のようにミストの拡 散係数は、気体分子に比べて格段に小さいため、拡散による輸送量が格段に小さ くなる。このため、ミスト成分の液膜への溶解速度が遅く、十分な除去性能が得 られない。

したがって、発生したミストを液への溶解によって十分に除去するためには、 拡散輸送以外の機構でミストの溶解を促進する必要がある。

20 このため本発明では、液中の気泡を撹拌羽根で破砕して気液界面の更新を促進 し、気液界面気相のミスト濃度を高く保つことにより、溶解を促進し高い除去性 能を得ることのできる装置としたものである。

次いで、通気撹拌槽5を出たガス6には、主に除去しきれなかった処理対象成分、また揮発性アルカリ液を使用した場合にはアンモニア、アミン等が含まれるので、適当な気液接触装置7で水8と接触させ、続いてデミスタ9で液滴が除去される。

ここで使用される気液接触装置としては、公知のものがいずれも使用できるが、

例えば図5(a)、図5(b)に記載のようなもので良い。

図5 (a) は、内部にラシヒリング22を充填した充填塔を示す。ラシヒリング22の上部より水8を充填物の上面に噴射させ、ガス6はその充填ゾーンを通過する際、気液接触される。

5 図5(b)は、内部にスプレーノズル23を設置したシャワー塔を示す。スプレーノズル23の先端から水8が水膜状に噴射されガスはその水膜を通過する際、 気液接触される。

気液接触後の水は排水管 1 0 から排出される。ここでアンモニア、アミン等はほとんど吸収され、作業環境許容濃度以下になる。

10 処理ガスは、吸引器12を通り装置から排出13される。使用できる吸引器12としては、高圧空気又は水をノズルより噴射させ、そこで発生する吸引力にて2次側を吸引負圧にするエジェクタ式の吸引器、ファン、水封ポンプ等がある。なお、吸引器は必須ではなく、2次側を負圧にする代わりに、1次側を正圧にしてもよい。例えば、1次側にファンを設けて、ガスを送気してもよい。

15 洗浄液4は、処理により消費され除去効率が低下する。そこで必要に応じて、 pH電極14で常時pHを測定し、規定のpHを下回った場合には、薬注ポンプ によりアルカリ液3を洗浄液に注入することが好ましい。

また、排ガス中の成分と水又はアルカリ液との反応生成物が洗浄液中に蓄積し、除去率の低下や生成物の析出を起こすことがある。そこで、一定量の水15を添加しながらオーバーフロー管2から洗浄液を排出して、生成物の蓄積を防ぐことが好ましい。

20

25

通気撹拌槽5としては、前記において、ディスクタービン型羽根を回転させ、 そのせん断力にてガスを分散化し、その羽根を上下2段に設置することにより更 にせん断力をつけ、かつガスの洗浄液中での滞留時間を長くさせるものについて 説明したが、それ以外でも、充分な気液接触効率を得ることができるものならば、 いかなる撹拌羽根でもかまわない。

気液接触装置7は、充分な気液接触効率が得ることができ、また吸引器12は

流入排ガス1の圧力状態が常時負圧に保たれるものであれば、前記以外のいかなる形式のものでもかまわない。

図2及び図3は、図1にさらに薬剤を充填した充填塔11を設けたものであり、 図2では、気液接触装置7の後段に、また、図3では気液接触装置7の前段に充 填塔11を設けたものである。

5

20

25

図2では、図1の処理で除去しきれなかった処理対象成分が残存する場合、適 当な薬剤を充填した充填塔11で作業環境許容濃度以下に吸着除去させている。

図3では、通気撹拌槽5を出てデミスタ16で液滴除去されたガス6には、主に除去しきれなかった処理対象成分、また揮発性アルカリ液を使用した場合にはアンモニア、アミン等が含まれるので、このガス6を、まず適当な薬剤を充填した充填塔11に通し、処理対象成分を作業環境許容濃度以下に吸着除去させる。ここで殆どの通気撹拌槽5で除去しきれなかった処理対象成分は除去されるが、アンモニア、アミン等が残存する場合がある。そこで、つぎにガスは適当な気液接触装置7で水8と接触され、アンモニア、アミン等はほとんど水に吸収され、処理ガスは吸引器12を通り装置から排出13される。

(B) 金属酸化物は $SiF_4$ 、 $NO_2$ 、 $NH_4C1$ などの除去に効果がある。金属酸化物としては、例えば、Cu-Mn複合酸化物、 $Fe_2O_3$ 等の遷移金属の酸化物が好適に用いられる。(C)陰イオン交換樹脂は $SiF_4$ 、 $Cl_2$ 、 $NH_4C1$ などの除去に効果がある。陰イオン交換樹脂は、第四アンモニウム基を有することが好ましい。また、陰イオン交換樹脂に限られず、所望により陽イオン交換樹脂単独、又は陽イオン交換樹脂と陰イオン交換樹脂との双方を使用してもよい。ソーダライムとしては、例えば、 $Na_2CO_3$ からなる粉体にNaOHからなる被膜が形成されたものが用いられる。

図6は、通気攪拌槽5と、その下流に配置された、薬剤を充填した充填塔11とを有する装置を示す。図6の装置には、気液接触装置7が設けられていない。図6の装置では、通気攪拌槽5には、アンモニア以外のアルカリ性溶液を用いることが好ましい。薬剤を用いるときには、アンモニアの除去に限界がある場合があるからである。もっとも、充填塔に適当な陽イオン交換樹脂を使う場合には、アンモニアも除去することができる。

薬剤を充填した充填塔により、 $SiF_4$ 等のハロゲン化ケイ素化合物、 $F_2$ 、 $Cl_2$ 等のハロゲンガスを除去することができる。

薬剤を充填した充填塔としては、従来の充填塔を用いることができる。例えば、1998年4月10日に出願された国際出願、PCT/JP98/01653、「排ガス中の窒素酸化物の除去方法」に記載された充填塔を用いることができる。また、1998年6月16日に日本国特許庁に出願された特願平10-168572号、「無機ハロゲン化ガスを含有する排ガスの処理方法」に記載された充填塔も用いることができる。国際出願 PCT/JP98/01653、及び、日本国特許出願 特願平10-168572号の開示は、本願に援用される。

#### 実施例

5

以下、本発明を実施例により具体的に説明する。

#### 実施例1

25

図2に示す処理装置を用いて、半導体製造用A1エッチング装置から排出され 20 る排ガスを処理した。半導体排ガスの流量は40リットル/minである。

半導体排ガス1は、まずアンモニア水3でpH8.5~9.5に調整された水4が満たされた通気撹拌槽5に導入され、モーター17で回転する撹拌羽根18によって微細化されて水4と接触される。撹拌羽根18の回転速度は600rpmとした。水4内に生成物が蓄積するのを防ぐために3リットル/minの水15を通気撹拌槽内に導入し、同量のブローダウン排水2を排水した。このブローダウン排水のpHをpH電極14で常にモニターし、pHが9を下回った時点でアンモニア水3を注入した。

通気撹拌槽を出た通気撹拌槽出口ガス 6 は、水シャワー 7 に通され、スプレーノズル 2 3 から噴霧される 5 リットル/minの水 8 と接触させた。接触後の水は、水シャワー排水 1 0 として排出した。スプレーノズル 2 3 から噴霧される水が、後段へ飛散するのを防止するために、水シャワーの出口にはデミスター 9 を設置した。水シャワーを出た水シャワーの出口ガス 2 4 は、充填塔 1 1 へ導入した。充填塔 1 1 には 1 0 リットルの陰イオン交換樹脂を充填した。充填塔を出た充填塔出口ガスは、空気 2 9 によって駆動される空気エジェクター 1 2 に導入され、処理済ガス 1 3 として排出される。空気 2 5 の導入量は 4 0 リットル/min とした。

10 以上のような構成でガス処理を行い、半導体排ガス1、通気撹拌槽出口ガス6、 水シャワー出口ガス24、処理済ガス13を分析した。この結果を表1に示す。

比較のために、pH調整のためにアンモニア水を用い、ラシヒリングを充填剤に用いた充填塔式スクラバーで同じ排ガスを処理した。その他の条件は実施例と同じである。この処理結果を表に示す。

. .

15 表 1

	半導体排ガス、1	通気撹拌槽出ロガス、6	水シャワー出 ロガス、24		
BCl3 (単位:ppm)	5000	< 1	< 1	< 1	< 1
C l 2	3000	2	2	< 0.5	3
(単位:ppm) AlCl <sub>3</sub>	10	< 1	< 1	< 1	< 1
(単位:ppm) NH₃	< 1	5 0	< 1	< 1	
(単位:ppm) B₂O₃	< 1	1 5	1 0	< 1	3 0 0
$(mg/m^3)$ NH <sub>4</sub> Cl	< 1	2 0	1 5	< 1	4 0 0
$\begin{array}{c} NH_4CI \\ (mg/m^3) \end{array}$	< 1	2 0	1 5	< 1	400

排ガスに含まれていた、 $BC1_3$ 、 $C1_2$ 、 $A1C1_3$  は各段の処理を受けることによって、処理済ガス中のこれらの成分の濃度は、いずれも検出限界以下であった。また、処理の過程で発生するNHa 、 $B_2O_3$  、 $NH_4C1$  のような成分も、水シャワーや、吸着塔によって検出限界以下まで処理されている。

充填塔スクラバーで処理した場合、 $B_2O_3$ 、 $NH_4C1$ がそれぞれ300mg  $/m^3$ 、400mg  $/m^3$ リークした。これに対して、通気撹拌槽で処理した場合には $B_2O_3$ 、 $NH_4C1$ のリーク濃度はそれぞれ15mg  $/m^3$ 、20mg  $/m^3$ であり、充填塔スクラバーに比べて1オーダー以上低かった。

#### 10 実施例 2

5

処理を、継続して1 ケ月間行ったが、半導体排ガスに含まれる固形物による装置内の閉塞や発熱等のトラブルは起こらなかった。また、処理終了後装置出口のダクト内の点検も行ったが、 $B_2O_3$  や $NH_4C$  I 等の粉体の付着は認められなかった。

### 15 実施例3

実施例1に示したような構成において、空気エジェクタ12に導入する空気25の流量を変化させた場合の装置入口圧力の変化を表2に示す。空気導入量を増すにしたがって、入口圧力は低下し、40リットル/min導入すると入口圧力は-150mmAqに達した。

20

表 2

	空気エジェクタへの導入空気量	装置入口圧力
	(リットル/m i n)	(mmAq)
25	0	+600
	1 0	+ 3 0 0
	2 0	+ 1 0 0
	3 0	- 5 0
	4 0	-150

30

2

#### 実施例4

5

10

15

図3に示す処理装置を用いて、半導体製造用A1エッチング装置から排出される半導体排ガスの処理を行った。排ガスの流量は120リットル/minである。半導体排ガス1は、まずアンモニア水3でpH8.5~9.5に調整された水4が満たされた通気撹拌槽5に導入され、モーター17で回転する撹拌羽根18によって微細化されて水4と接触される。撹拌羽根18の回転速度は600rpmとした。水4内に生成物が蓄積するのを防ぐために3リットル/minの水15を通気撹拌槽内に導入し同量のブローダウン排水2を排水した。このブローダウン排水のpHをpH電極14で常にモニターし、pHが9を下回った時点でアンモニア水3を注入した。

通気撹拌槽を出た通気撹拌槽出口ガス6を、充填塔11へ導入した。充填塔には10リットルの陰イオン交換樹脂を充填した。充填塔を出た充填塔出口ガスは、水シャワー7に通され、スプレーノズル23から噴霧される5リットル/minの水8と接触させた。接触後の水は水シャワー排水10として排出した。スプレーノズル23から噴霧される水が後段へ飛散するのを防止するために、水シャワーの出口にはデミスター9を設置した。水シャワーを出た水シャワーの出口ガス24は、空気25によって駆動される空気エジェクター12に導入され、処理済ガス13として排出される。空気25の導入量は90リットル/minとした。

以上のような構成でガス処理を行い、半導体排ガス1、通気撹拌槽出口ガス6、 20 充填塔出口ガス、処理済ガス13を分析した。この結果を表3に示す。

表 3

	半導体排ガス	通気撹拌槽 出口ガス 6		処理済ガス 13	
BCl <sub>3</sub> (単位:ppm)	5000	< 1	< 1	< 1	
C l 2	3000	2	< 0.5	< 0.5	

(単位:ppm) AlCl <sub>3</sub>	1 0	< 1	< 1	< 1	
(単位:ppm) NH₃ (単位:ppm)	< 1	8 0	1 0 0	< 1	
(単位:ppm) B₂O₃ (単位:ppm)	< 1	4 0	1 0	< 1	
NH <sub>4</sub> Cl (mg/m <sup>3</sup> )	< 1	8 0	1 5	< 1	

排ガスに含まれていた、 $BC1_3$ 、 $C1_2$ 、 $A1C1_3$  は各段の処理を受けることによって、処理済ガス中のこれらの成分の濃度は、いずれも検出限界以下であった。また、処理の過程で発生する $NH_3$ 、 $B_2O_3$ 、 $NH_4C1$ のような成分も、水シャワーや、充填塔によって検出眼界以下まで処理されている。

本発明によれば、次のような効果を奏することができる。

- (1)上述のように本処理方法では、通気撹拌槽を初段に採用することにより、 処理対象成分と水又はアルカリ液との反応生成物が後段にリークすることを防止 10 し、生成物によるトラブルを低減できる。
  - (2)後段に充填塔を装備すれば、処理性能は乾式並みになる。
  - (3) 充填塔を装備する場合でも、処理対象成分の大部分は湿式処理段で除去される為、充填塔は非常に小型で済み、かつライフも長いので、交換にかかる手間やランニングコストが著しく低減される。
- 15 (4) 充填塔に濃縮される有害物は少量であるため、発熱等のトラブルが起こり にくく、使用済み薬剤の安定化も容易である。
  - (5) 通気撹拌槽のガス流入圧力は正圧となるが、後段に吸引器を設置することで、上流側の真空ポンプの負荷を低減できる。

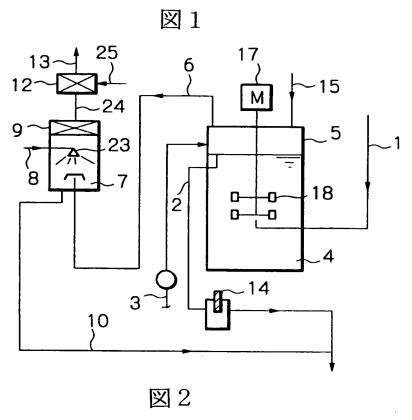
#### 請求の範囲

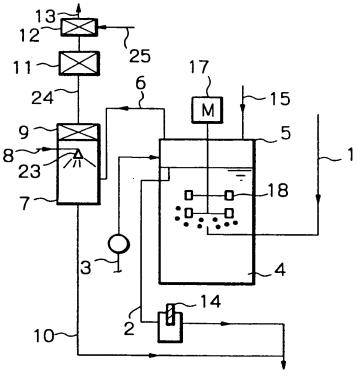
- 1. 通気攪拌槽中のアルカリ性水性液を攪拌しつつ、排ガスをアルカリ性水性液に導入する工程と、
- 5 通気攪拌槽から排出されるガスから更に有害ガスを除去する工程と、 を有することを特徴とする排ガスの処理方法。
  - 2. 前記除去工程が、通気攪拌槽から排出されるガスを水性液に接触させる工程 を有することを特徴とする排ガスの処理方法。
- 3. 前記除去工程が、通気攪拌槽から排出されるガスを薬剤を充填した充填塔に 10 導入させる工程を有する請求項1に記載の排ガスの処理方法。
  - 4. 前記除去工程が、通気攪拌槽から排出されるガスを水性液に接触させる工程と、通気攪拌槽から排出されるガスを薬剤を充填した充填塔に導入させる工程と、を有する請求項1に記載の排ガスの処理方法。
- 5. 前記アルカリ性水性液がアルカリ金属元素を含まない水溶液であり、前記水 15 溶液のpHが7. 1~10である請求項1~4の何れかに記載の排ガスの処理方 法。
  - 6. 通気攪拌槽から排出されるガスが、ガス移動装置により移動させられる上記請求項の何れかに記載の排ガスの処理方法。
- 7. 半導体デバイス製造装置から排ガスを放出する工程を更に有し、この排ガス 20 を上記導入工程で上記アルカリ性水性液に導入する上記請求項の何れかに記載の 排ガスの処理方法。
  - 8. アルカリ性水性液を攪拌しつつ、排ガスをアルカリ性水性液に導入するための通気攪拌槽と、
- 前記通気攪拌装置から排出されたガスを水性液に接触させるための気液接触装 25 置、及び、前記通気攪拌装置から排出されたガスを通すための、薬剤を充填した 充填塔の少なくとも一方と、

を有する排ガスの処理装置。

9. 前記気液接触装置を有する請求項8に記載の排ガスの処理装置。

- 10. 前記充填塔を有する請求項8に記載の排ガスの処理装置。
- 11. 前記気液接触装置及び前記充填塔を有する請求項8に記載の排ガスの処理装置。
- 5 12. 通気攪拌槽を通過したガスを移動させるための、ガス移動装置を更に有する請求項8~11の何れかに記載の排ガスの処理装置。
  - 13. 半導体デバイスの製造装置から排出される排ガスを前記通気攪拌槽に導入するための通路を有する請求項8~12の何れかに記載の排ガスの処理装置。





		,	
			۸.
,			*

図 3

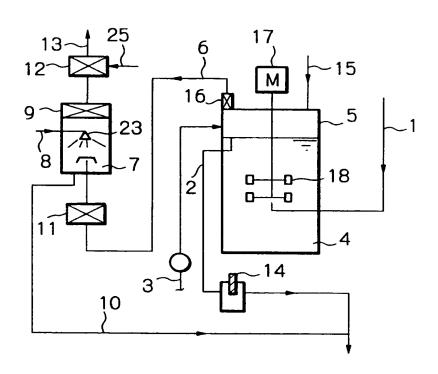


図4 (a)

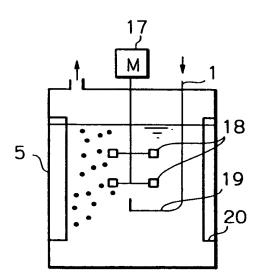
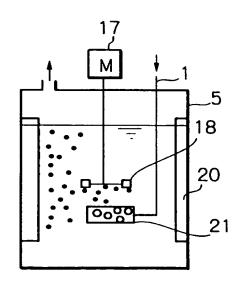


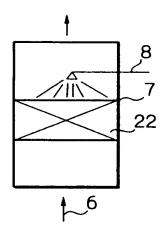
図4 (b)

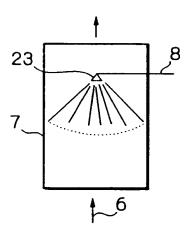


	•		
			•
			,7×
			r
		./4	•

図5 (a)

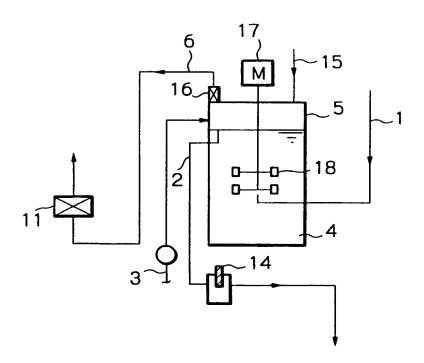
図5 (b)





				•
				e
·				
				•
	÷			

図 6



				•
				e
				· ·
				•
	- 6			
	.3-			

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP98/04666

		LL	<del></del>		
	A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl <sup>6</sup> B01D53/75, B01D53/78				
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both nat	tional classification and IPC			
	S SEARCHED				
Int.	ocumentation searched (classification system followed b C1 B01D53/34, B01D53/75, B01D	053/78	·		
Jitsu Kokai	i Jitsuyo Shinan Koho 1971-1999	Toroku Jitsuyo Shinan Koho Jitsuyo Shinan Toroku Koho	o 1994–1999 o 1996–1999		
Electronic d	ata base consulted during the international search (nam	e of data base and, where practicable, se	earch terms used)		
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where app		Relevant to claim No.		
X Y	JP, 3-242215, A (Iwatani & C 29 October, 1991 (29. 10. 91) Page 2, upper left column, li (Family: none)	),	1, 3, 7, 8, 10, 13 6, 12		
X Y	JP, 8-309147, A (Kobe Steel, Ltd.), 26 November, 1996 (26. 11. 96), Claims 5, 8, 9; Fig. 5 (Family: none)				
х	Microfilm of Japanese Utility No. 118088/1974 (Laid-open No (Kajima Corp.), 30 September, Page 4, line 11 to page 5, 15 (Family: none)	o. 44744/1976) , 1974 (30. 09. 74),	1, 3, 5-8, 10, 12		
X Y	JP, 8-57254, A (Masataka Ish 5 March, 1996 (05. 03. 96), Par. Nos. [0018], [0019] ; F:		1, 2, 8, 9 3, 4, 6, 10-12		
× Furth	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	I		
* Special categories of cited documents:  "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance earlier document but published on or after the international filing date  "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed  "C" tater document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention cannot be considered novel or cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance;					
8 Ja	Date of the actual completion of the international search 8 January, 1999 (08. 01. 99) 19 January, 1999 (19. 01. 99)				
	mailing address of the ISA/ anese Patent Office	Authorized officer			
Facsimile !	No.	Telephone No.			

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP98/04666

C (Continua	tion). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the releva	int passages	Relevant to claim No.
Y	JP, 62-125827, A (Seitetsu Kagaku Kogyo Co 8 June, 1987 (08. 06. 87), Page 2, upper right column, line 16 to lo column, line 7; Fig. 1 (Family: none)		1-3, 6-10, 12, 13
A	Microfilm of Japanese Utility Model Appl. No. 118723/1973 (Laid-open No. 22568/1978) (Yamazaki Denki Kogyo K.K.), 15 October, 1973 (15. 10. 73), Claims (Family: none)	ication 8)	1-13
A	JP, 7-148414, A (Toshiro Maruyama), 13 June, 1995 (13. 06. 95), Fig. 1 (Family: none)		1-13

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

国際出願番号 PCT/JP98/04666 国際調査報告 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) B01D53/75, B01D53/78 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) B01D53/34, B01D53/75, B01D53/78 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-1999年 日本国登録実用新案公報 1994-1999年 日本国実用新案登録公報 1996-1999年 国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) 関連すると認められる文献 関連する 引用文献の カテゴリー\* 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号 3-242215, A (岩谷産業株式会社) 1, 3, 7, X 8, 10, 13 29. 10月. 1991 (29. 10. 91) 第2頁左上欄第2-18行(ファミリーなし) 6, 12 Y JP, 8-309147, A (株式会社神戸製鋼所) 26.11月.1996 (26.11.96) 1 - 4X 8 - 11請求項5,8,9,第5図(ファミリーなし) 6, 12 Y 日本国実用新案登録出願49-118088号(日本国実用新案登 1, 3, X 5 - 8, 録出願公開51-44744号)のマイクロフィルム 10, 12 (鹿島建設株式会社) | パテントファミリーに関する別紙を参照。 |x| C欄の続きにも文献が列挙されている。 \* 引用文献のカテゴリー の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 もの 論の理解のために引用するもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 以後に公表されたもの の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに 文献(理由を付す) 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 国際調査報告の発送日 国際調査を完了した日 08.01.99 19.01.99

特許庁審査官(権限のある職員)

電話番号 03-3581-1101 内線 3421

服部 智

9831

4 D

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
	30.9月.1974 (30.09.74) 第4頁第11行-第5頁第2行,第1図 (ファミリーなし)	
X	JP, 8-57254, A (石川 雅堂) 5.3月.1996 (05.03.96)	1, 2, 8,
Y	段落番号【0018】【0019】, 第1図 (ファミリーなし)	$\begin{bmatrix} 3, & 4, & 6, \\ 1 & 0 - 1 & 2 \end{bmatrix}$
Y	JP, 62-125827, A (製鉄化学工業株式会社) 8.6月.1987 (08.06.87) 第2頁右上欄第16行-左下欄第7行,第1図 (ファミリーなし)	$\begin{bmatrix} 1-3, \\ 6-10, \\ 12, 13 \end{bmatrix}$
A	日本国実用新案登録出願48-118723号(日本国実用新案登録出願公開53-22568号)のマイクロフィルム (山崎電気工業株式会社)	1-13
	15.10月.1973 (15.10.73) 実用新案登録請求の範囲 (ファミリーなし)	
A	JP, 7-148414, A (丸山俊朗) 13. 6月. 1995 (13. 06. 95) 第1図 (ファミリーなし)	1-13

## 発信人 日本国特許庁 (国際予備審査機関)

出願人代理人

社本 一夫

殿

PCT

あて名

T 100-0004 東京都千代田区大手町2丁目2番1号 新大手町ピル206区 ユアサハラ法律特許事務所

国際予備審査報告の送付の通知書

(法施行規則第57条) [PCT規則71.1]

発送日 (日.月.年) 26.10.99

出願人又は代理人 の書類記号・

YCT-369

重要な通知

国際出願番号

PCT/JP98/04666

国際出願日

15. 10. 98 (日.月.年)

優先日 (日.月.年)

17. 10. 97

出願人(氏名又は名称)

株式会社在原製作所

- 1. 国際予備審査機関は、この国際出願に関して国際予備審査報告及び付属審類が作成されている場合には、それらをこの 送付書とともに送付することを、出願人に通知する。
- 2. 国際予備審査報告及び付属書類が作成されている場合には、すべての選択官庁に通知するために、それらの写しを国際 事務局に送付する。
- 3. 選択官庁から要求があったときは、国際事務局は国際予備審査報告(付属書類を除く)の英語の翻訳文を作成し、それ をその選択官庁に送付する。

#### 4. 注 意

出願人は、各選択官庁に対し優先日から30月以内に(官庁によってはもっと遅く)所定の手続(翻訳文の提出及び国内 手数料の支払い)をしなければならない (PCT39条 (1)) (様式PCT/IB/301とともに国際事務局から送付 された注を参照)。

国際出願の翻訳文が選択官庁に提出された場合には、その翻訳文は、国際予備審査報告の付属書類の翻訳文を含まなけれ ばならない。

この翻訳文を作成し、関係する選択官庁に直接送付するのは出願人の責任である。

選択官庁が適用する期間及び要件の詳細については、PCT出願人の手引き第Ⅱ巻を参照すること。

名称及びあて名

日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 権限のある職員

特許庁長官

4 D

9831

電話番号 03-3581-1101 内線 6431

THIS PAGE BLANK (USPTO)

#### PCT

#### 国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 YCT-369	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCI) IPEA/416)を参照すること。						
国際出願番号 PCT/JP98/04666	国際出願日 (日.月.年) 15.10.98	優先日 (日.月.年)	17. 10. 97				
国際特許分類 (IPC) Int.Cl <sup>6</sup> B01D53/75, B01D53/78							
出願人(氏名又は名称)	株式会社荏原	製作所					
IV 開の単一性の欠如	紙を含めて全部で 4 附属書類、つまり補正されて む明細書、請求の範囲及び/ 実施細則第607号参照) ヘージである。 容を含む。	ページからなる。 、この報告の基礎とされた 又は図面も添付されている	た及び/又はこの国際予備審 5。				
VII □ 国際出願に対する意見							

国際予備審査の請求書を受理した日 26.01.99	国際予備審査報告を作成した日 13.10.99
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 4D 9831 吉水 純子 電話番号 03-3581-1101 内線 6431

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Ι.		国際予備審査報					-
1.	F	の国際予備報 答するために PCT規則70.	.提	出された差し替え用紙は、	きづいて作成され この報告書にま	れた。 (法第6条 (PCT14条) の規定に基づく命令に おいて「出願時」とし、本報告書には添付しない。 ・	
•		出願時の国際	出系	碩書類			
	X	明細書 明細書 明細書	第第第	1-14	_ ページ、 _ ページ、 _ ページ、 _ ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの	,
	X	請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲	第第	2-7, 9-13	項、 項、 項、 項、	出願時に提出されたもの PCT19条の規定に基づき補正されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの23.06.99 付の書簡と共に提出されたもの	>
	X	図面 図面	第第第	1-6	<del>ページ</del> /図、 ページ/図、 ページ/図、 	国際予備審査の請求書と共に提出されたもの	>
		明細書の配列 明細書の配列 明細書の配列	列表	の部分 第	ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求費と共に提出されたもの 	ס
2.	-	上記の出願書	質の	言語は、下記に示す場合	を除くほか、こ	の国際出願の官語である。	
3	上記の書類は、下記の言語である 語である。  □ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語 □ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語 □ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語 □ 国際・日本会のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語 3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。 □ この国際出願に含まれる書面による配列表 □ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表 □ 出願後に、この国際・予備審査(または調査)機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表 □ 出願後に、この国際・予備審査(または調査)機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表 □ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった □ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。						l l
		] 明細書 ] 請求の範囲 ] 図面	9 1 第 E	この書類が削除された。 第 第 図面の第	~ ^ <u>`</u>	ージ/図	) h
5		カスので	70	審査報告は、補充欄に示し の補正がされなかったもの 5 判断の際に考慮しなける	のとして作成し	正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認めた。 (PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙的報告に添付する。)	让

v.	新規性、 文献及び	進歩性又は産業上の利用可能性につい 対説明	いての法第12条 	(PCT35条(2))	に定める見解、	それを裏付ける
1.	見解					
	新規性(1	1)	請求の範囲 _ 請求の範囲 _	1-13		有 無
	進歩性()	ıs)	請求の範囲 _ 請求の範囲 _	1-13		有 無
	産業上の和	利用可能性 (IA)	請求の範囲 <sub>-</sub> 請求の範囲 <sub>-</sub>	1-13		有 無

#### 2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

(文献は下記文献一覧参照。) 請求の範囲1,3,8,10は、国際調査報告で引用された文献1,2,3又は4により進歩性を 有しない。排ガス処理方法及び装置において、気液接触を高めるため攪拌機を用いる ことは国際調査報告で引用された文献7に記載されているように周知である。

請求の範囲2及び9は、文献2又4により進歩性を有しない。排ガス処理方法及び装置において、気液接触を高めるため攪拌機を用いることは文献7に記載されているように周知である。

請求の範囲4及び11は、文献2又4により進歩性を有しない。排ガス処理方法及び装置において、気液接触を高めるため攪拌機を用いることは文献7に記載されているように周知である。

請求項5,7,13は、文献1と新たに引用した文献5から進歩性を有しない。排ガス処理方法及び装置において、気液接触を高めるため攪拌機を用いることは文献7に記載されているように周知であり、新たに引用した文献5で教示されたシラン吸収除去剤であるアンモニア水溶液を半導体製造工程からのシランを除去する文献1に適用することは当業者が容易になし得ることである。

請求項6及び12は、文献1乃至4により進歩性を有しない。排ガス処理方法及び装置において、気液接触を高めるため攪拌機を用いることは文献7に記載されているように周知であり、気液接触装置の後段にガス移動装置を設けることも文献3に記載されているように周知である。

#### 文献一覧

文献1. JP, 3-242215, A (岩谷産業株式会社) 29. 10月. 1991 (29. 10. 91) 第2頁左上欄第2-18行

文献2. JP, 8-309147, A (株式会社神戸製鋼所) 26. 11月. 1996 (26. 11. 96) 請求項5, 8, 9, 第5図 備考:中和液の滞留可能な吸収水槽と、吸収水槽からの排ガスが供給されるガス洗

# 補充欄 (いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

#### 第 V. 欄の続き

浄塔、活性炭吸着槽を用いたフロンの燃焼分解からの排ガスを処理する方法及び装置が記載されている。

文献3.日本国実用新案登録出願49-118088号(日本国実用新案登録出願公開51-44744号)のマイクロフィルム(鹿島建設株式会社)30.9月.1974(30.09.74)第4頁第11行-第5頁第2行,第1図備考:アンモニア水を収容する下筒と固形吸収剤を装備した上筒からなり、上筒に排気ファンを取り付けた脱臭装置及び該装置を用いた脱臭方法が記載されている。

文献4. JP, 8-57254, A (石川 雅堂) 5. 3月. 1996 (05. 03. 96) 段落番号【0018】【0019】, 第1図 備考:排ガスをアルカリ液に吸収させた後、フィルター、稀アルカリ液シャワーで 処理する方法及び装置が記載されている。

文献5. JP, 60-125228, A (三井東圧化学株式会社) 04.07月.1985 (04.07.85) 第3表 備考:半導体製造排ガス中のシランをアンモニア水溶液で接触処理する方法及び装置が記載されている。

文献7. J P, 7-148414, A (丸山俊朗) 13.6.1995 (13.0 6.95) 第1図 備考:薬液と排ガスの接触面積を増加させるため、薬液を攪拌する回転インペラー を備えた装置が記載されている。

PCT EP 国際調査報告

出願人又は代理人

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 YCT-36	6 <b>9</b>	今後の手続き	については	、国際調査報 及び下記 5	告の送付通知様式 を参照すること。	(PCT/ISA	/220)
国際出願番号 PCT/JP98/046	6 6	国際出願日	15.10	). 98	優先日 (日.月.年) 1	7. 10. 97	
出願人 (氏名又は名称)		株式会社有	<b>E原製作所</b>				
国際調査機関が作成したここの写しは国際事務局にも	の国際調査 が送付される	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	規則第41条	(PCT18\$	条)の規定に従い! ・	出願人に送付する	5.
この国際調査報告は、全部	3で3	ページであ	る。				
この調査報告に引用さ	れた先行技	が文献の写し	も添付され、	ている。		•	
1. 国際調査報告の基礎 a. 言語は、下記に示す □ この国際調査機	場合を除く 関に提出さ	ほか、この国[ れた国際出願の	祭出願がされ 翻訳文に基	れたものに基っ づき国際調査	づき国際調査を行っ を行った。	った。	<u> </u>
b. この国際出願は、ヌ この国際出願に この国際出願とも 出願後に、この 出願後に、この 出願後に、この 出願後に提出した 書の提出があった	クレオチトウスを表しています。 中に提出される。 国際調査機関のである。 では、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	又はアミノ酸配面による配列表 れたフレキシブ 関に提出された 関に提出された る配列表が出願	記列を含ん・ ルディスク 書面による フレキシブ 時における	でおり、次の配 による配列表 配列表 ルディスクに、 国際出願の開	己列表に基づき国際	事項を含まない。	
2.	-	できない(第1	欄参照)。			,	
3. ② 発明の単一性が	欠如してい	る(第Ⅱ 欄参照	g) .				
4. 発明の名称は	x 出願	人が提出したも	のを承認す	<sup>-</sup> る。			
•	□次に	示すように国際	、 ※調査機関か	作成した。		•	
5. 要約は `	区 出願	人が提出したも	のを承認す	· る。			
	1 別と	関に示されてい 関査機関が作成 祭調査機関に意	した。出解	[人は、この国	47条(PCT規則 際調査報告の発送 る。	38.2(b)) の規定 の日から1カ月	こにより以内にこ
6. 要約書とともに公表され 第 <u>3</u> 図とする。		人が示したとお	りである。		□なし		
	区 出願	人は図を示さな	かった。			· ·	
	本図	は発明の特徴を	一層よく表	している。	· ·		10
						<del></del>	

Α.	発明の属する分野の分類	(国際特許分類	(IPC))

Int. Cl° B01D53/75, B01D53/78

#### 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

B01D53/34, B01D53/75, B01D53/78 Int. Cl

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-1999年

日本国登録実用新案公報

1994-1999年

日本国実用新案登録公報

1996-1999年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X Y X Y	JP, 3-242215, A(岩谷産業株式会社) 29.10月.1991(29.10.91) 第2頁左上欄第2-18行(ファミリーなし) JP, 8-309147, A(株式会社神戸製鋼所) 26.11月.1996(26.11.96) 請求項5,8,9,第5図(ファミリーなし)	1, 3, 7, 8, 10, 13 6, 12 1-4, 8-11 6, 12
Х	日本国実用新案登録出願49-118088号(日本国実用新案登録出願公開51-44744号)のマイクロフィルム (鹿島建設株式会社)	1, 3, 5-8, 10, 12

#### |x| C欄の続きにも文献が列挙されている。

| | パテントファミリーに関する別紙を参照。

- 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す)
- 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 論の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献 国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 08.01.99 190199 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 9831 4 D 日本国特許庁 (ISA/JP) 服部 智 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3421

	•			
国	陰。	百杏	如	告

C (6± ±)	四部上で1979と1979	0/ 04 0 0 0
C (続き). 引用文献の	関連すると認められる文献	門本上マ
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
	30.9月.1974 (30.09.74) 第4頁第11行-第5頁第2行,第1図 (ファミリーなし)	-
X	JP, 8-57254, A (石川 雅堂) 5.3月.1996 (05.03.96)	1, 2, 8,
Y	段落番号【0018】【0019】, 第1図 (ファミリーなし)	$ \begin{vmatrix} 9 \\ 3, 4, 6, \\ 10-12 \end{vmatrix} $
Y	JP,62-125827,A(製鉄化学工業株式会社) 8.6月.1987(08.06.87) 第2頁右上欄第16行-左下欄第7行,第1図(ファミリーなし)	$ \begin{vmatrix} 1 - 3, \\ 6 - 1 0, \\ 1 2, 1 3 \end{vmatrix} $
A	日本国実用新案登録出願48-118723号(日本国実用新案登録出願公開53-22568号)のマイクロフィルム	1-13
 	(山崎電気工業株式会社) 15.10月.1973 (15.10.73) 実用新案登録請求の範囲 (ファミリーなし)	
Α	JP, 7-148414, A (丸山俊朗) 13. 6月. 1995 (13. 06. 95)	1-13
	第1図(ファミリーなし)	
		in the state of t
		*
1		
	et en	
		,
*.		
· I	ı	

THIS PACE BLANK USPROV

#### PCT

#### NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES

(PCT Rule 47.1(c), first sentence)

#### From the INTERNATIONAL BUREAU

SHAMOTO, Ichio Yuasa and Hara New Ohtemachi Building, Section 206 2-1, Ohtemachi 2-chome

Chiyoda-ku Tokyo 100-0004 **JAPON** 

Date of mailing (day/month/year)

29 April 1999 (29.04.99)

Applicant's or agent's file reference

YCT-369

IMPORTANT NOTICE

International application No. PCT/JP98/04666

International filing date (day/month/year) 15 October 1998 (15.10.98)

Priority date (day/month/year) 17 October 1997 (17.10.97)

**Applicant** 

EBARA CORPORATION et al

1. Notice is hereby given that the International Bureau has communicated, as provided in Article 20, the international application to the following designated Offices on the date indicated above as the date of mailing of this Notice:

EP; JP, KR, US

In accordance with Rule 47.1(c), third sentence, those Offices will accept the present Notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

2. The following designated Offices have waived the requirement for such a communication at this time:

#### None

The communication will be made to those Offices only upon their request. Furthermore, those Offices do not require the applicant to furnish a copy of the international application (Rule 49.1 (a-bis)).

3. Enclosed with this Notice is a copy of the international application as published by the International Bureau on 29 April 1999 (29.04.99) under No. WO 99/20374

## REMINDER REGARDING CHAPTER II (Article 31(2)(a) and Rule 54.2)

If the applicant wishes to postpone entry into the national phase until 30 months (or later in some Offices) from the priority date, a demand for international preliminary examination must be filed with the competent International Preliminary Examining Authority before the expiration of 19 months from the priority date.

It is the applicant's sole responsibility to monitor the 19-month time limit.

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination.

# REMINDER REGARDING ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE (Article 22 or 39(1))

If the applicant wishes to proceed with the international application in the national phase, he must, within 20 months or 30 months, or later in some Offices, perform the acts referred to therein before each designated or elected Office.

For further important information on the time limits and acts to be performed for entering the national phase, see the Annex to Form PCT/IB/301 (Notification of Receipt of Record Copy) and Volume II of the PCT Applicant's Guide.

The International Bureau f WIPO 34, chemin des Colombett s 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

J. Zahra

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

Telephone No. (41-22) 338.83.38

## PATENT COOPERATION TREATY

	From the INTERNATIONAL BUREAU
PCT	To:
NOTIFICATION OF ELECTION  (PCT Rule 61.2)	United States Patent and Trademark Office (Box PCT) Crystal Plaza 2 Washington, DC 20231 ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Date of mailing: 29 April 1999 (29.04.99)	in its capacity as elected Office
International application No.: PCT/JP98/04666	Applicant's or agent's file reference: YCT-369
International filing date: 15 October 1998 (15.10.98)	Priority date: 17 October 1997 (17.10.97)
Applicant: IKEDA, Hiroshi et al	
in the demand filed with the International preliminary  26 January 199  in a notice effecting later election filed with the International preliminary  27. The election   X   was     was not   was not   was not   was not   Rule 32.2(b).	9 (26.01.99) etional Bureau on:

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer:

J. Zahra

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

 $\mathbf{r}_{h}^{\mathbf{r}_{h}^{-1}}$ 

## PATENT COOPERATION TREATY

#### From the INTERNATIONAL BUREAU

#### **PCT**

#### NOTIFICATION CONCERNING SUBMISSION OR TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENT

(PCT Administrative Instructions, Section 411)

SHAMOTO, Ichio
Yuasa and Hara
New Ohtemachi Building, Section 206
2-1, Ohtemachi 2-chome
Chiyoda-ku
Tokyo 100-0004
JAPON

SHAMOTO, Ichio
Yuasa and Hara
PATENT
PATENT
ONISION

IMPORTANT NOTIFICATION  fonal filing date (day/month/year) October 1998 (15.10.98)  date (day/month/year) October 1997 (17.10.97)
October 1998 (15.10.98)  date (day/month/year)

- The applicant is hereby notified of the date of receipt (except where the letters "NR" appear in the right-hand column) by the
  International Bureau of the priority document(s) relating to the earlier application(s) indicated below. Unless otherwise
  indicated by an asterisk appearing next to a date of receipt, or by the letters "NR", in the right-hand column, the priority
  document concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b).
- 2. This updates and replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents.
- 3. An asterisk(\*) appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes a priority document submitted or transmitted to the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a) or (b). In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.
- 4. The letters "NR" appearing in the right-hand column denote a priority document which was not received by the International Bureau or which the applicant did not request the receiving Office to prepare and transmit to the International Bureau, as provided by Rule 17.1(a) or (b), respectively. In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

Priority date
Priority date
Priority application No.
Country or regional Office of priority document
Priority date
Or PCT receiving Office
Or PCT receiving Office
Priority date
Option 1997 (17.10.97)

9/299671

JP
22 Janu 1999 (22.01.99)

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

R. Forax

RF

Facsimile No. (41-22) 740.14.35 Telephone No. (41-22) 338.83.38





Europäisches Patentamt

Zweigstelle in Den Haag Recherchenabteilung European Patent Off

Branch al The Hague Search division Office europé n des brevets

Département à La Haye Division de la recherche

Wagner, Karl H., Dipl.-Ing. Wagner & Geyer, Patentanwälte, Gewürzmühlstrasse 5 80538 München ALLEMAGNE

Wagner & Geyer

17. Feb. 2003

EINGANG FECEIVED

Datum/Date

18.02.03

Zeichen/Ret /Ret

Y-E-17588/614

Anmeldung Nr./Application No./Demande n°./Patent Nr./Patent No./Brevet n°.

98947890.4-2113-JP9804666

Anmelder-Applicant/Demandeur/Patentinhaber/Proprietor/Titulaire EBARA CORPORATION

# COMMUNICATION

The European Patent Office herewith transmits as an enclosure the European search report for the above-mentioned European patent application.

If applicable, copies of the documents cited in the European search report are attached.

Additional set(s) of copies of the documents cited in the European search report is (are) enclosed as well.

## REFUND OF THE SEARCH FEE

If applicable under Article 10 Rules relating to fees, a separate communication from the Receiving Section on the refund of the search fee will be sent later.



PAGE BLANK (USPTO)



## SUPPLEMENTARY **EUROPEAN SEARCH REPORT**

**Application Number** EP 98 94 7890

D	OCUMENTS CONSIDE	RED TO BE RELEVANT		
Category	Citation of document with inco		Relevant to claim	CLASSIFICATION OF THE APPLICATION (Int.CI.6)
	US 4 719 088 A (ITOH 12 January 1988 (198 * column 2, line 20 * column 4, line 26 claim 1; figure 2 *	FUMIO ET AL) 8-01-12) - column 3, line 48 * - column 6, line 39;	1,2,5-8	B01D53/75 B01D53/78 B01D53/68
	EP 0 684 067 A (TAMA; TOKYO SHIBAURA ELEC 29 November 1995 (19 * page 2, line 36-53 * page 3, line 36 - claims 1-9 *	TRIC CO (JP)) 995-11-29) 3 *	1-8	
	EP 0 673 669 A (JAPA 27 September 1995 (1 * page 3, line 3-26 * page 4, line 9-53	1995-09-27) *	1-8	
	EP 0 792 681 A (JAPA 3 September 1997 (19 * page 3, line 3-45 * page 4, line 23-3	997-09-03) *	1-8	TECHNICAL FIELDS SEARCHED (Int.CI.6)  B010
				\$\$************************************
			-	
	The supplementary search repo set of claims valid and available	rt has been based on the last		
	I set of claims valid and available	at the start of the search.	1	1

CATEGORY OF CITED DOCUMENTS

MUNICH

1

EPO FORM 1503 03.82 (P04C04)

X : particularly relevant if taken alone
 Y : particularly relevant if combined with another document of the same category
 A : technological background
 O : non-written disclosure
 P : intermediate document

T : theory or principle underlying the invention
 E : earlier patent document, but published on, or after the filing date
 D : document cited in the application
 L : document cited for other reasons

12 February 2003

&: member of the same patent family, corresponding document

Maremonti, M



EP 98 94 7890

This annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned European search report. The members are as contained in the European Patent Office EDP file on The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information.

12-02-2003

Patent docume cited in search re		Publication date		Patent fam member(s		Publication date
US 4719088	A	12-01-1988	JP JP JP DE KR	4072565 61204022 3604403	C B A A1 B1	12-11-1993 18-11-1992 10-09-1986 14-08-1986 05-08-1989
EP 0684067	Α	29-11-1995	CN DE DE EP JP TW	1121439 69524479 69524479 0684067 8057246 406028	A ,B D1 T2 A1 A B	01-05-1996 24-01-2002 30-01-2003 29-11-1995 05-03-1996 21-09-2000
EP 0673669	Α	27-09-1995	JP DE DE EP US	7308538 69521226 69521226 0673669 5670445	A D1 T2 A2 A	28-11-1995 19-07-2001 16-05-2002 27-09-1995 23-09-1997
EP 0792681	A	03-09-1997	JP DE DE EP US	9234337 69619219 69619219 0792681 5756060	A D1 T2 A1 A	09-09-1997 21-03-2002 29-08-2002 03-09-1997 26-05-1998

Translation ()

5650 PATENT COOPERATION TRACTY

# **PCT**

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference YCT-369	FOR FURTHER ACTION	SeeNotificationofTransmittalofInternational Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)
International application No. PCT/JP98/04666	International filing date (day/m 15 October 1998 (15.	
International Patent Classification (IPC) or n B01D 53/75, 53/78	<u> </u>	
Applicant	EBARA CORPORA	ATION
and is transmitted to the applicant acc.  This REPORT consists of a total of  This report is also accompaniamended and are the basis for 70.16 and Section 607 of the	decording to Article 36.  4 sheets, including the day ANNEXES, i.e., sheets of	of the description, claims and/or drawings which have been thing rectifications made before this Authority (332) Rule
IV Lack of unity of inv  V Reasoned statement citations and explan  VI Certain documents of	of opinion with regard to novelty ention under Article 35(2) with regard ations supporting such statement	ty, inventive step and industrial applicability  d to novelty, inventive step or industrial applicability; nt
VIII Certain observations	s on the international application	in
Date of submission of the demand	Date of	of completion of this report
26 January 1999 (26.0	1.99)	13 October 1999 (13.10.1999)
Name and mailing address of the IPEA/JP	Author	orized officer
Facsimile No.	Telepho	hone No.

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

## PCT/JP98/04666

I. Basis of the report									
1. With regard to the elements of the international application:*									
		the international application as originally filed							
	$\overline{\boxtimes}$	the des	cription:						
		pages	1-14	, as originally filed					
		pages		, filed with the demand					
		pages	, filed with the letter of						
	$\square$	the clai	me:						
		pages	2-7,9-13	, as originally filed					
		pages	, as amended (together v						
		pages	(\dagger)	, filed with the demand					
		pages	1,8 , filed with the letter of						
	$\triangle$	the drav							
		pages	1-6	, as originally filed					
		pages		, filed with the demand					
		pages	pages, filed with the letter of						
	t	he seque	nce listing part of the description:						
		pages		, as originally filed					
		pages							
		pages	, filed with the letter of						
2.	the ir	nternation e elemen	o the language, all the elements marked above were available or furnished to this nal application was filed, unless otherwise indicated under this item. ts were available or furnished to this Authority in the following language guage of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule)	which is:					
	H		guage of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).	c 23.1(0)).					
	뭄			overmination (under Pule 55.2 and/					
_	ш 	or 55.3	the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).						
3.			to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the internation was carried out on the basis of the sequence listing:	onal application, the international					
	$\square$	contain	ed in the international application in written form.						
	$\square$	filed to	gether with the international application in computer readable form.						
	$\square$	furnish	ed subsequently to this Authority in written form.						
	$\square$		ed subsequently to this Authority in computer readable form.						
			atement that the subsequently furnished written sequence listing does not tional application as filed has been furnished.	go beyond the disclosure in the					
	Ш		atement that the information recorded in computer readable form is identical turnished.	o the written sequence listing has					
4.		The am	nendments have resulted in the cancellation of:						
			the description, pages						
•			the claims, Nos.						
		$\overline{}$	the drawings, sheets/fig						
5.		This rep	port has been established as if (some of) the amendments had not been made, since the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**	ce they have been considered to go					
	in th	icement : is report 70.17).	sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitating as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not	ion under Article 14 are referred to contain amendments (Rule 70.16					
	** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.								

#### INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No. PCT/JP 98/04666

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement					
Statement					
Novelty (N)	Claims	1-13	YES		
	Claims		NO		
Inventive step (IS)	Claims		YES		
	Claims	1-13	NO		
Industrial applicability (IA)	Claims	1-13	YES		
	Claims		NO		

2. Citations and explanations

(See the list of documents below for cited documents)

Claims 1, 3, 8 and 10 do not involve an inventive step in light of Documents 1, 2, 3 and 4. The method and apparatus for treating exhaust gas using a stirring device to increase gas-liquid contact are, as disclosed in Document 7 cited in the international search report, common practice.

Claims 2 and 9 do not involve an inventive step in light of Documents 2 and 4. The method and apparatus for treating exhaust gas using a stirring device to increase gas-liquid contact are, as disclosed in Document 7 cited in the international search report, common practice.

Claims 4 and 11 do not involve an inventive step in light of Documents 2 and 4. The method and apparatus for treating exhaust gas using a stirring device to increase gas-liquid contact are, as disclosed in Document 7 cited in the international search report, common practice.

Claims 5, 7 and 13 do not involve an inventive step in light of Document 1 and newly cited Document 5. The method and apparatus for treating exhaust gas using a stirring

device to increase gas-liquid contact are, as disclosed in Document 7, common practice. Moreover, it would be easy for a person skilled in the art to apply the ammonia aqueous solution that is a silane absorption/removal agent disclosed in Document 5 to the method of removing the silane from a semiconductor manufacturing process disclosed in Document 1.

Claims 6 and 12 do not involve an inventive step in light of Documents 1 to 4. The method and apparatus for treating exhaust gas using a stirring device to increase gas-liquid contact are, as disclosed in Document 7, common practice. Moreover, the feature of installing a gas-moving device on the rear step of the gas-liquid contact device is common practice, as disclosed in Document 3.

#### Reference Documents

Document 1 (JP, 3-242215, A (Iwatani & Co., Ltd.),
October 29, 1991 (29.10.91), page 2, upper left column,
lines 2 to 18) discloses a method and apparatus for
treating exhaust gas provided with a treatment tank, which
stores an alkaline aqueous solution for an exhaust gas
supply passage that supplies exhaust gas from the
semiconductor manufacturing process to a treatment tower
filled with a treatment agent.

Document 2 (JP, 8-309147, A (Kobe Steel, Ltd.),
November 26, 1996 (26.11.96), Claims 5, 8 and 9; Fig. 5)
discloses a method and apparatus for treating exhaust gas
from the combustion decomposition of flon using an
absorption water tank that is capable of delaying the
delivery of a neutralising liquid, a gas washing tower and
an activated charcoal absorption tank for supplying
exhaust gas from the absorption water tank.

Document 3 (Microfilm of specification and drawings annexed to the request of Japanese Utility Model
Application No. 118088/1974 (Laid-open No. 44744/1976),
September 30, 1974 (30.09.74), page 4, line 11 to page 5,
line 2; Fig. 1) discloses an odour-eliminating device
comprising a lower pipe containing ammonia water and an
upper pipe having a solid absorbent, wherein an exhaust
fan is installed on the upper pipe, and a method for
eliminating odours using said device.

Document 4 (JP, 8-57254, A (Masataka Ishikawa), March 5, 1996 (05.03.96), paragraph [0018] and [0019]; Fig. 1) discloses a method and device for treating an exhaust gas after absorbing an alkaline liquid with a filter and a diluted alkaline liquid shower.

Document 5 (JP, 60-125228, A (Mitsui Toatsu Chemicals, Inc.), July 4, 1985 (04.07.85), Table 3) discloses a method and device for contact-treating silane in an exhaust gas in a semiconductor manufacturing process with an ammonia aqueous solution.

Document 7 (JP, 7-148414, A (Toshiro Maruyama), June 13, 1995 (13.06.95), Fig. 1) discloses a device provided with a rotating impeller, which stirs a chemical in order to increase the contact area of said chemical and an exhaust gas.

\*\*\*\*\*